

FO-PLP対応 感光性樹脂へのニッケルシード層形成プロセス
 Nickel Seed Layer Forming Process Applicable to FO-PLP Photosensitive Resin

トップPSRプロセス

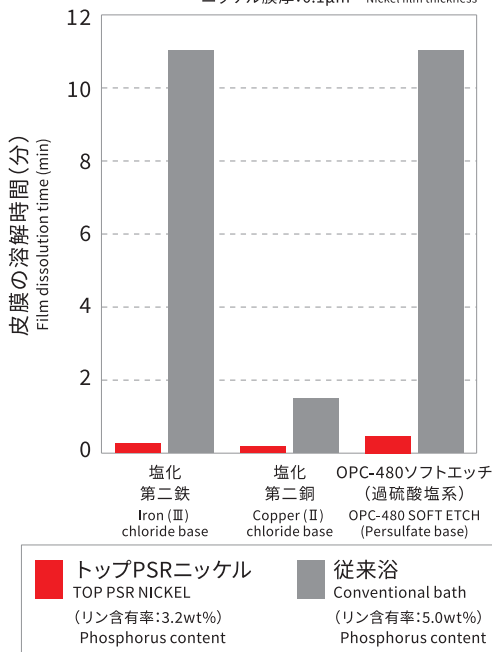
TOP PSR PROCESS

- 全湿式プロセスでメタライズ可能
Can metallize by all wet process
- FO-PLPに適したニッケルシード層形成プロセス
Nickel seed layer forming process applicable to FO-PLP
- ニッケルシード層のエッチング性に優れ、ファインパターン形成が可能
High etching power to nickel seed layers, can form fine patterning
- 密着性に優れる
Excellent in adhesion

優れたファインパターン性 Excellent in fine pattern ability

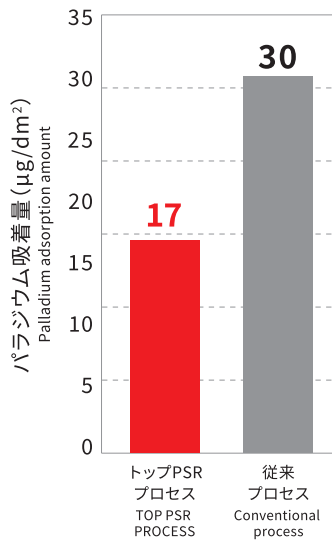
シード層エッチング性に優れる
High etching power to nickel seed layers

ニッケル膜厚:0.1 μ m Nickel film thickness

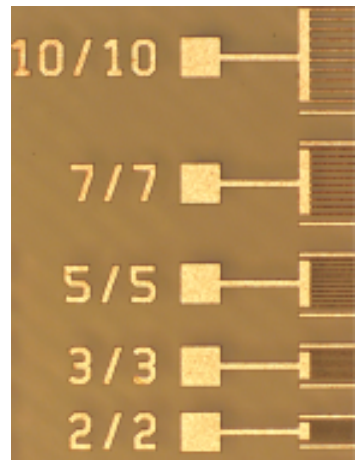


皮膜溶解性と皮膜リン含有率の比較
Relationship of film dissolubility and phosphorus content in film

ニッケル/金めっき時のパターン性に優れる
Excellent in fine pattern ability of nickel/gold plating



パラジウム吸着量の比較
Comparison of palladium adsorption amount



パターン作成例
Example of pattern formation

FO-PLP:絶縁層/配線層形成パネル(東レ株式会社様作製パネル)

FO-PLP: Dielectric layer/patterning layer panel (Made and presented by TORAY INDUSTRIES, INC.)



シード層形成:トップPSRプロセス
Seed layer formation: TOP PSR PROCESS



FIB-SEM像 FIB-SEM image

湿式プロセスで超微細配線形成を可能にする
Can form ultra-fine patterns by wet process